

### — 熱の基本から電子回路基板の熱評価まで —

近年、電子機器の小型化・高機能化に伴い、その開発・設計では増大する電力密度に対する放熱の問題を避けて通ることは出来ない。特にEVなどに用いられる高発熱密度パワーエレクトロニクスでは、放熱と冷却技術が大きな課題となっている。

本セミナーでは、新人の方を含めた電子回路基板の開発・設計に携わる技術者を対象として、熱の移動、冷却技術、熱抵抗および熱回路の基礎、現場で役立つ温度計測や熱抵抗計測技術、さらには電子回路基板の放熱性能評価規格に関して講ずる。



#### 募集要項

開催日時：2019年11月28日(木) 13:00-17:10  
(受付開始 12:30-)

会場：回路会館地下1階会議室

東京都目黒区西荻北3-12-2/一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

地図： [http://jpca.jp/jpca\\_about/access/](http://jpca.jp/jpca_about/access/)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

#### ●プログラム (時間は質疑時間10分を含みます。内容については予定であり変更する場合があります。)

13:00-13:40	<b>伝熱の基礎と相変化を伴う伝熱</b> 鈴木 康一 山口東京理科大学 名誉教授 (標準化推進委員会 熱関連標準化WG主査)
13:40-14:40	<b>電子回路基板の放熱とシミュレーション</b> 畠山 友行 富山県立大学 准教授 (標準化推進委員会 熱関連標準化WG幹事)
14:40-14:50	<b>休憩</b>
14:50-15:50	<b>電装分野における高放熱基板および高熱部材の放熱対策</b> 米村 直己 デンカ(株) (熱関連標準化WG委員)
15:50-17:10	<b>発熱部品を搭載した電子回路基板の熱解析 - Excel による迅速熱解析の適用例と演習 - ※要 PC</b> 富村 寿夫 元熊本大学 教授

#### ●参加要項

定員：先着35名

参加費：10,000円(税込) JPCA 会員様

15,000円(税込) 非会員様

※懇親会にご出席希望(オプション)の場合は、5,000円(税込)を頂戴いたします。

※ご受講予定者と別の方が受講される場合には、事前にメール等でご連絡を頂くか、セミナー当日に受付にてお申し出ください。

※講演では、Microsoft Excelによる熱解析を行うため、PCを持参ください。

※資料は当日配布いたします。

※懇親会のキャンセルは、11月21日(木)までにお申し出ください。それ以降の場合は返金できませんのでご注意ください。

#### ●お問い合わせ

一般社団法人日本電子回路工業会 事業部 熱関連標準化WG担当

E-mail: std2@jpca.org TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021

#### ●申込方法

別紙申込書に必要事項をご入力の上、メールまたはFAXで11月18日(月)迄にお申し込み下さい。工業会からご担当者様宛に請求書をお送りさせていただきます。

